

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	2
Einleitung	6
1 Anwendungsbereich	7
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	8
3.1 Grundbegriffe.....	8
3.2 Allgemeine Begriffe	9
3.3 Begriffe für die Herstellung von Halbleiterbauelementen sowie für die Anschluss- und Verbindungstechnologie	11
4 Allgemeine Anforderungen	13
5 Datenaustausch.....	13
6 Anforderungen an alle Bauelemente.....	13
6.1 Datenpaket	13
6.2 Bezeichnung und Bezugsquelle	14
6.3 Funktion	14
6.4 Physikalische Kenngrößen	14
6.5 Kennwerte und begrenzende Bedingungen	15
6.6 Verbindungen	15
6.7 Dokumentation	15
6.8 Form der Anlieferung.....	16
6.9 Simulation und Modellierung	16
7 Anforderungen an Nacktchips und Wafer mit oder ohne Anschluss- und Verbindungsstrukturen	16
7.1 Allgemeines	16
7.2 Bezeichnung	16
7.3 Werkstoffe.....	17
7.4 Geometrische Kenngrößen	18
7.5 Waferdaten	19
8 Bauelemente in minimalen Gehäusen	19
8.1 Allgemeines	19
8.2 Anzahl der Anschlüsse	19
8.3 Lage der Anschlüsse	19
8.4 Form und Größe der Anschlüsse	20
8.5 Bauelementgröße	20
8.6 Aufsetzhöhe.....	20
8.7 Gehäuse- und Verschlusswerkstoff.....	20
8.8 Feuchteempfindlichkeit.....	20
8.9 Code der (Gehäuse-)Bauform.....	20
8.10 Gehäusezeichnung.....	20

	Seite
9	Qualität, Prüfung und Zuverlässigkeit..... 21
9.1	Allgemeines 21
9.2	Ausgangs-Qualitätslage..... 21
9.3	Festlegungen zu elektrischen Kenngrößen 21
9.4	Einhaltung von Normen 21
9.5	Zusätzliches Bauelemente-Screening 21
9.6	Erzeugnisstatus 21
9.7	Prüfbarkeitsmerkmale 22
9.8	Zusätzliche Prüfanforderungen..... 22
9.9	Zuverlässigkeit 22
10	Handhabung und Transport..... 22
10.1	Allgemeine Anforderungen 22
10.2	Besondere Anforderungen für Nacktchips und Wafer – Maskenversion..... 24
10.3	Besondere Anforderungen für Wafer – Wafer-Mapping 24
10.4	Besondere Anforderungen..... 24
11	Lagerung..... 25
11.1	Allgemeines 25
11.2	Lagerungsdauer und -bedingungen..... 25
11.3	Langzeitlagerung 25
11.4	Einschränkungen zur Lagerung..... 25
12	Montage 25
12.1	Allgemeines 25
12.2	Befestigungsverfahren und -werkstoffe 25
12.3	Bondverfahren und -werkstoffe..... 25
12.4	Beschränkungen zur Montage..... 26
12.5	Prozessbeschränkungen 26
Anhang A (informativ) Terminologie 27	
A.1	Begriffe zur Montage..... 27
A.2	Begriffe zur Prüfung..... 27
A.3	Begriffe zu Halbleiterbauelementen..... 29
A.4	Montagetechnologie..... 31
A.5	Begriffe zu Entwurf und Simulation..... 33
A.6	Begriffe zu Verpackung und Lieferung 36
A.7	Begriffe zur Handhabung..... 38
A.8	Begriffe zur Herstellung 38
Anhang B (informativ) Akronyme 39	
B.1	Organisationen und Normen..... 39
B.2	Allgemeine Terminologie 39
B.3	Terminologie der Herstellung und Prüfung..... 40

	Seite
B.4 Halbleiter.....	41
B.5 Entwurf, Simulation und Datenaustausch	41
B.6 Elektronische Schaltungstechnik.....	42
B.7 Gehäusemontage (Packaging).....	43
Literaturhinweise.....	44
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	45